

（株）プリンテック
代表取締役社長

富樫 栄樹 氏



さらに顧客ニーズに対応した無溶剤防湿絶縁コーティング用シート「Meit+」も自信作の1つだ。

この課題克服に成功した。最新のHRYSPでは耐熱が260℃、10GHz時の誘電正接は0.002であり、ガラスクロス誘電正接0.004を凌ぐ特性を發揮できている。

となるはずだ。2〜3年後にはHRシリーズで売上高10億円を目指している。

富樫 22年度（23年3月期）の売上高は前年度比約6%増の37億円となり、利益面でも増益を果たせた。23年度も売上高40億円と増収継続を見込んでいる。産業用ロボット、工作機械、半導体製造装置など堅実に成長中のお客様が多いことも当社の業績に奏功している。今後も熱硬化樹脂材の強みを活かし、配合剤と高機能基板をコアとする当社技術を求める領域で拡大を図っていく。

プリント基板を創業のルートとし、そのノウハウを活かした高付加価値な回路材料、半導体基板および回路加工品で右肩上がりの堅実な成長を続ける（株）プリンテック（神奈川県厚木市）。最近では誘電正接に優れる高耐熱樹脂「HRシリーズ」や、環境に優しい無溶剤防湿絶縁コーティング用シート「Meit+」（メルトプラス）など豊富な知見を活かした新材料・新技術の上市で注目を集めている。前身の三井化学時代から化学材料に精通し、2016年から代表取締役社長として同社を率いる富樫栄樹氏に話を聞いた。

事業構成から。富樫 エポキシ樹脂の製造・販売、複数の材料を混ぜ合わせた配合剤な

つである基板アートワーク力は、限られた基板スペースに数百点の部品を効率よく実装する部品配置設計であり、お客様か

HRシリーズの特徴について詳細を。富樫 中長期的に伸長が見込まれる5G、ミリ波レーダーなどの高周波

使用時のユーザーメリットは。富樫 ガラスクロスには誘電特性劣化という課題があり、ガラスクロス

富樫 実装系のお客様から、環境に優しく、スプレー式のように塗りを気にせず、水分から実装基板を完全保護することから創出されたシ

ト厚1mmの固形シートである。上下貼り合わせコーティングを最短1分で実現でき、無溶剤かつグリーン原料使用による環境負荷低減、低吸水性素材採用で低吸水性最大0.66%も実現。生産効率向上、環境貢献など今後の伸びに期待している。

高機能樹脂から実装基板まで一貫

アートワーク力、配合剤などに強み

どの①回路材料、プリントチップパッケージ基板をメインとした②半導体基板、基板上に部品を実装する③回路製品の三本柱で事業展開している。金額ベースの比率は加工度の高い③が60%を占める。なお、基本的にはフ

らの評価も高く、試作から量産まで一貫でお任せいただけるケースが多い。また、配合剤では熱硬化樹脂を中心とする低誘電特性に優れる基板材

・高速通信用プリント基板では、耐熱特性と誘電特性を合わせ持つビスマレイミッド樹脂ニーズが高い。しかし、ビスマレイミッド樹脂は有機溶剤に非常に溶けにくく、軟化点も高いため、基板材料として扱いにくいというのが実情だ。当社のHRシ

フリーで市場を席捲するボンディングフィルム（BF）は高額である。ガラスクロスフリーなBFを独自に創出したイメ

ト厚1mmの固形シートである。上下貼り合わせコーティングを最短1分で実現でき、無溶剤かつグリーン原料使用による環境負荷低減、低吸水性素材採用で低吸水性最大0.66%も実現。生産効率向上、環境貢献など今後の伸びに期待している。

「品質でお客様の満足を得る」ことを方針とし、新材料開発から先端の回路加工製品まで全社員一丸で顧客ニーズに応えていく。

貴社の強みは。富樫 当社の強みの1

のと自信を持っている。

価値を生み出せる好機

業績面を含めた今

（聞き手・高澤里美記者）

